

特点

1. 中心放大门极结构
2. 平板型陶瓷管壳封装
3. 低通态和开关损耗

典型应用

- | | | |
|------------|-----------|--------------------------------------|
| 1. 大功率变流器 | I_{FAV} | 800A |
| 2. 焊接设备 | V_{RRM} | 1600V |
| 3. 电机控制和驱动 | I_{FSM} | 11KA |
| | I^2t | 600 10 ³ A ² S |



主要参数

符号	参数	测试条件	结温	参数值			单位
			Tj(°C)	最小	典型	最大	
I_{FAV}	正向平均电流	180° 正弦半波, 50Hz 双面散热, $T_{hs}=120^{\circ}\text{C}$	150			800	A
I_{FAV}	正向平均电流	180° 正弦半波, 50Hz 双面散热, $T_{hs}=55^{\circ}\text{C}$	150			1704	V
V_{RRM}	反向重复峰值电压	$V_{RRM} t_p=10\text{ms}$, $V_{RSM} = V_{RRM}+100\text{V}$	150		1600		mA
I_{RRM}	反向重复峰值电流	$V_R=V_{RRM}$	150			50	KA
I_{FSM}	正向不重复峰值电流	10ms底宽, 正弦半波	150			11	A ² *10 ³
I^2t	浪涌电流平方时间积	$V_R=0.6V_{RRM}$	150			600	V
V_{FO}	门槛电压	$I_{TM}=1500\text{A}$, $F=15\text{KN}$	25			0.88	mΩ
r_F	斜率电阻		150			0.17	V
V_{FM}	正向峰值电压		150			2.0	A
I_m	反向恢复电压	$I_{TM}=600\text{A}$, $t_p=1000 \mu\text{s}$,	150				μs
t_{rr}	反向恢复电流	$di/dt=-20\text{A}/\mu\text{s}$,					μC
Q_{rr}	恢复电荷	$V_R=50\text{V}$					
$R_{th(j-h)}$	热阻抗(结至散热器)	180° 正弦波, 双面散热; 压紧力18KN				0.035	°C /W
F_m	安装力					20	KN
T_{stg}	存储温度					160	°C
W_t	质量						g
Size	包装盒尺寸						mm

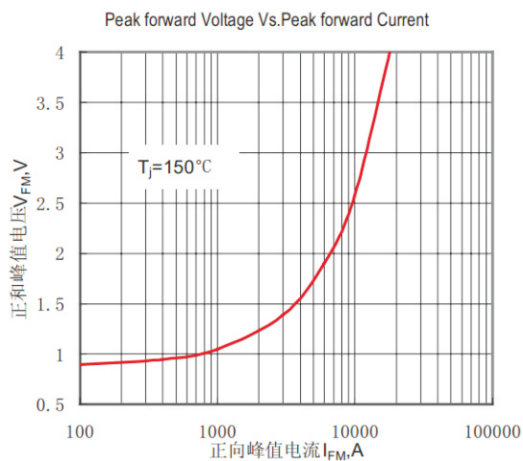


Fig.1 正向伏安特性曲线

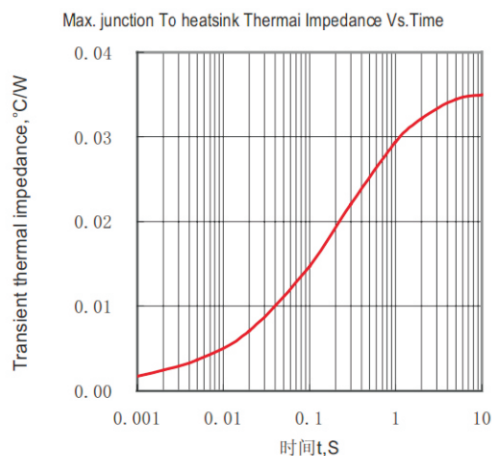


Fig.2 结至散热器瞬态热阻抗曲线

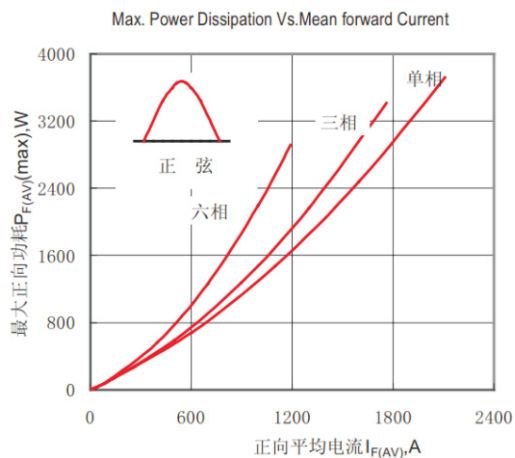


Fig.3 最大功耗与正向平均电流关系曲线

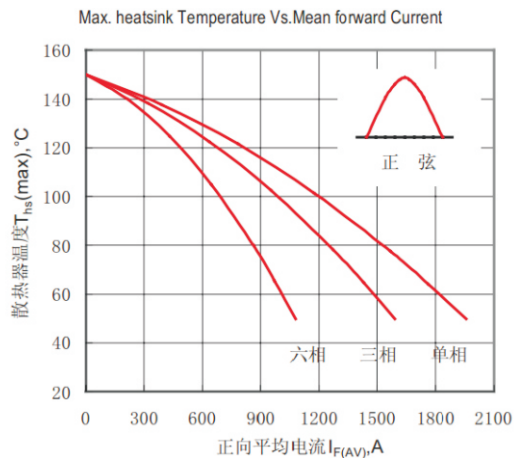


Fig.4 散热器温度正向平均电流 关系曲线

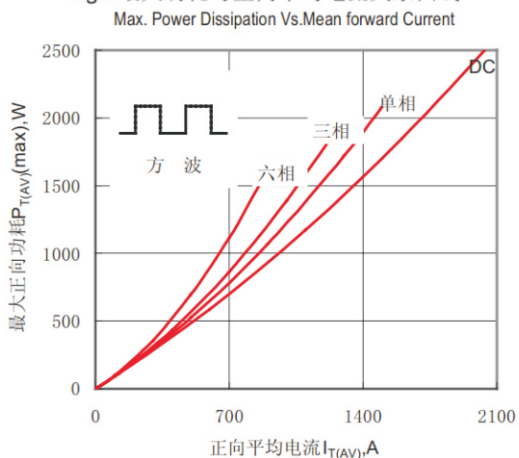


Fig.5 最大功耗与正向平均电流关系曲线

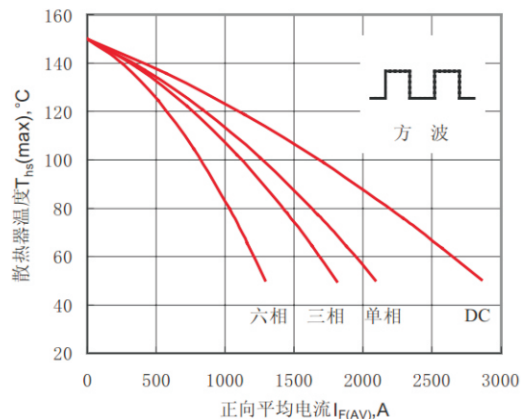


Fig.6 散热器温度正向平均电流 关系曲线

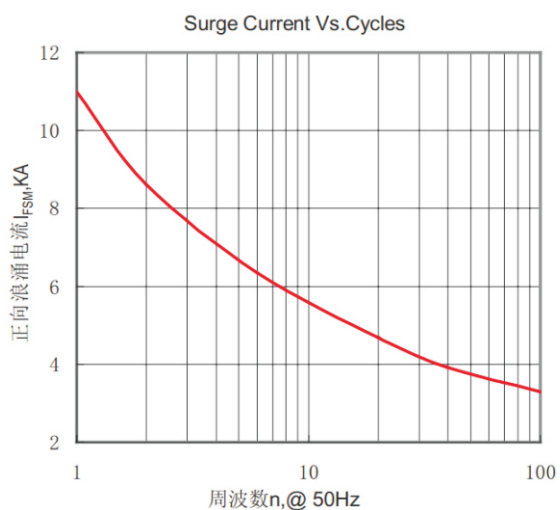


Fig.7 正向浪涌电流与周波数的关系曲线

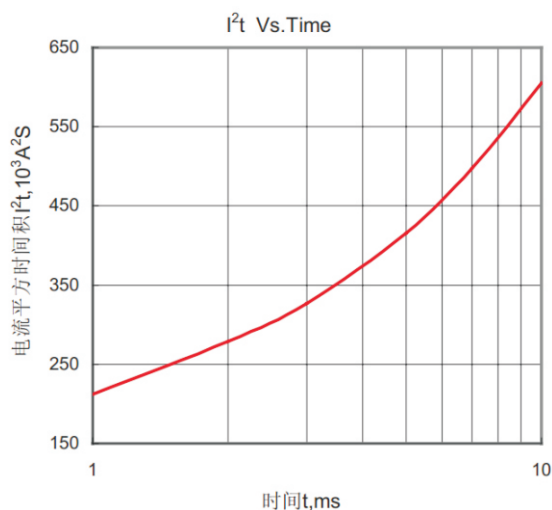


Fig.8 I^2t 特性曲线

外形尺寸图

